

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-005

沪士电子股份有限公司

关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 投资新建项目名称：应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目（下称“本项目”）。

- 总投资额：约 19.8 亿元人民币。
- 资金来源：公司自有或自筹资金。
- 建设周期：本项目将分阶段实施，本项目总建设期计划为 4 年。
- 特别风险提示：

➢ 本项目总投资额较高，且建设资金来源于公司自有或自筹，因此本项目的资金保障可能会受到公司现有厂区的经营情况的影响。

➢ 本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

➢ 由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。

● 其他：本项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；本项目不会对公司 2021 年经营业绩产生重大影响。

一、概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2021年2月1日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本项目的基本情况

（1）项目名称：

应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目。

（2）建设地点：

位于江苏省苏州市昆山市玉山镇东龙路1号的公司青淞厂区预留用地。

（3）总投资额：

本项目投资总额约为19.8亿元人民币,包括基础建设投入、设备投入、铺底流动资金等。

（5）资金来源：

公司自有或自筹资金。

（6）建设周期：

本项目将分阶段实施，本项目总建设期计划为4年。

（7）产品方案和生产规模：

本项目计划年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的高层高密度互连积层板以及165,000平方米应用于下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板。

（8）项目可行性分析：

本项目预估年营业收入约为24.8亿元人民币，其中应用于半导体芯片测试领域的产品营业收入约为5亿元人民币，应用于半下一代高频高速通讯领域的产品营业收入约为19.8亿元人民币；扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约为4.7亿元人民币；考虑所得税，税率以15%计算，净利润约为4亿元人民币。

本项目财务评价计算期14年（含建设期4年），折现率按10%，经测算项目投

资财务内部收益率所得税后约为 17%，高于基准收益率；项目所得税后投资回收期约为 8 年（含建设期 4 年）。从以上分析看，本项目所得税后财务净现值大于 0，投资回收期，内部收益率适中，从项目投资价值分析角度考虑，项目可行。

本项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺；本项目不会对公司 2021 年度经营业绩产生重大影响。

三、本项目对公司的影响

本项目利用自主研发技术，产品主要应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯市场，符合国家相关的产业政策、行业发展趋势，符合公司坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略，能进一步扩大公司的高端产品产能，并更好的配合满足客户未来需求，具有良好的市场发展前景。本项目的实施将进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，完善产业布局，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。

四、本项目的风险分析及应对

1、本项目总投资额较高，且建设资金来源于公司自有或自筹，因此本项目的资金保障可能会受到公司现有厂区的经营情况的影响。公司近年来经营情况良好，现金流稳定，现金储备较为充裕，负债率在同业中相对较低，公司将统筹资金安排，以确保项目顺利实施；

2、本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目实施提供多方面的支持，全力配合各项审批工作的推进。

3、由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能，提高产品竞争力，以降低市场风险。

五、独立董事意见

公司投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目的规划符合公司发展战略，合理可行，其实施有利于进一步扩大公司经营规模，优化产品结构，完善产业布局，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日